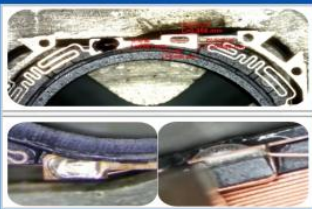


激光锡球焊接机



设备特点

- **高效率:**焊接速度快,最快0.3S/焊点。
- **高精度:**焊点一致性高,锡球直径为50 μ m~1500微米,适用于精密产品如;CCM摄像头模组、VCM摄像头马达、FPC连接、金手指、汽车电子、感应器、热敏感元器件、芯片植球、光电子产品。
- **免清洁:**无飞溅,锡球无助焊剂,焊接后免清洗。
- **安全:**激光聚焦光斑小,热影响区域小,能在常规方式不易施焊部位进行加工,无挤压应力,不会损伤工件。



音圈马达



芯片植球



光通讯



激光锡球焊接机

技术参数

设备型号	HC-SBJC21
波长	1064nm
激光功率	75W-300W
锡球尺寸	50 μ m-1500 μ m
上料方式	在线上/双工位(可选)
工作范围	725mm x 525mm/220mm x 140mm
加工精度	\pm 0.002mm
整机供电	AC 220V 10A
空气压力	0.4-0.6Mpa
氮气压力	0.4-0.6Mpa
设备重量	650kg

